

令和7年4月23日

先端技術産業振興課
直 通：092-643-3445
内 線：3772
担 当：渡邊、小野

パワー半導体の先進パッケージ技術に関する国際学会 の福岡開催が決定！

～ISAPP 実行委員会が開催報告のため服部知事を訪問します～

パワー半導体の性能向上を図るための先進的な後工程技術に関する国際学会「ISAPP (International Symposium on Advanced Power Packaging)」が11月5日～7日に、福岡県（会場：福岡国際会議場）で開催することが決定しました。

この報告のため、4月28日（月）に、ISAPP 実行委員会が服部知事を訪問します。

福岡県は、九州最多となる約400社の半導体関連企業が集積し、三菱電機パワーデバイス製作所やローム・アポロ株式会社といった世界を代表するパワー半導体の製造企業が立地するほか、三次元半導体研究センター等、後工程に強みを持つ研究開発支援機関も立地していることから、今後のさらなる産学官連携を期待されて開催地に選ばれたものです。

1 日時

令和7年4月28日（月） 13:00～13:30

※知事訪問後、ISAPP 実行委員会による質疑応答の時間を設けます。

2 場所

福岡県庁8階 特別会議室

3 訪問者（ISAPP実行委員会）

菅沼 克昭 実行委員長

（大阪大学産業科学研究所フレキシブル3D実装共同研究所 所長/特任教授）

小迫 雅裕 実行副委員長（九州工業大学 教授）

塩崎 宏司 実行副委員長（名古屋大学 特任教授）

西原 和則 プログラム委員（名古屋大学 招へい教員）

山田 登三雄 委員（株式会社九州電化 代表取締役会長）

4 次第

（1）出席者紹介

（2）菅沼実行委員長 ご挨拶及び概要説明

（3）服部知事 挨拶

（4）歓談

（5）記念撮影

(参考)

【ISAPP (International Symposium on Advanced Power Packaging) 概要】

- ・カーボンニュートラルの実現を支える次世代パワーエレクトロニクスの先進パッケージング技術に関する研究成果を共有し、自動車・電車・飛行機などの電動モビリティ、産業用ロボット、IoT、再生可能エネルギー等の関連製品への応用課題を検討することを目的とした国際学会。
- ・2019年に発足し、大阪府で第1回を開催。その後、新型コロナウイルス感染症等の影響で開催を中断し、今年第2回を福岡県で開催。
- ・次世代パワーエレクトロニクス分野に関わる国内外の研究者及び企業関係者が参加。

日 時：令和7年11月5日～7日（5日～6日 学会、7日 企業等視察）

会 場：福岡国際会議場 多目的ホール

参加予定：300名

対象分野：パッケージ材料、プロセス技術・装置、パッケージング、信頼性・テスト

【訪問者プロフィール】

菅沼 克昭 実行委員長

(大阪大学産業科学研究所フレキシブル 3D 実装共同研究所 所長/特任教授)

これまで、世界初の鉛フリーはんだの実用化やアルミニウムをセラミック基板に鋳造で貼り付ける技術（初代ハイブリット自動車に採用）等を開発した実績を持つ。

1994年、日本初の「鉛フリーはんだ研究会」を立ち上げ、2005年には、「ワイドバンドギャップ半導体 (WBG) 実装コンソーシアム」につながる産学連携活動を通じて、銀 (Ag) 焼結接合技術を提案。

2011年には現在、90社以上が参画する「プリントドエレクトロニクス (PE) 研究会」を立ち上げるなど、産学連携を積極的に主導しながらさまざまな成果を創出。

そして2020年、より一層の産学連携を図るべく大阪大学フレキシブル 3D 実装協働研究所を設立し、「フレキシブル 3D 実装コンソーシアム」を始動。

